## 中国杂光

# 铺粉层厚对选区激光熔化成形 AlSi10Mg 合金质量及 效率的影响

闫泰起<sup>1</sup>,陈冰清<sup>1\*</sup>,唐鹏钧<sup>1</sup>,楚瑞坤<sup>2</sup>,郭绍庆<sup>1</sup> <sup>1</sup>中国航发北京航空材料研究院 3D 打印研究与工程技术中心,北京 100095; <sup>2</sup>飞而康快速制造科技有限责任公司,江苏 无锡 214145

**摘要** 研究了铺粉层厚对选区激光熔化成形 AlSi10Mg 合金致密度、微观组织、拉伸性能及成形效率的影响。实验结果表明,在优化的激光能量密度区间内,30 µm 低层厚和 60 µm 高层厚下成形的试样致密度均可达到 99.00%以上,且具有良好的拉伸性能。但 30 µm 低层厚成形试样的强度略高于 60 µm 高层厚,目 30 µm 低层厚成形试样在 平行成形方向的延伸率明显高于 60 µm 高层厚,原因是 30 µm 低层厚成形试样的拉伸裂纹很难在尺寸更小、排布 更密集的熔池边界扩展。研究结果还表明,30 µm 低层厚成形试样的缺陷多分布在熔池边界,而 60 µm 高层厚成 形试样的缺陷多分布在熔池内部。此外,在成形质量相近的情况下,高层厚的成形效率约为低层厚的 2.7 倍。 关键词 激光技术;选区激光熔化;铺粉层厚;致密度;拉伸性能;成形效率

**中图分类号** TN249 文献标志码 A

doi: 10.3788/CJL202148.1002106

#### 1 引 言

AlSi10Mg 合金属于铸造铝合金,具有密度低、 工艺性好及耐蚀性强等特点,广泛应用于航空航天、 仪表、汽车等领域<sup>[1]</sup>。随着各行各业对产品技术水 平要求的提高,结构功能一体化、轻量化以及研制周 期成为铝合金构件制造过程中需要重点考虑的问 题<sup>[2]</sup>。近年来,选区激光熔化(SLM)成形技术的快 速发展为新型铝合金构件的制造提供了新途径<sup>[3]</sup>。 SLM 成形技术先通过专用软件将待成形零件的三 维模型切片分层后,利用高能激光束按照每层切片 的图形数据逐层选择性地熔化金属粉末。然后通过 逐层铺粉、熔化凝固堆积的方式制造出实体零 件<sup>[4-5]</sup>。借助辅助支撑和熔化区外的粉末,SLM 成 形技术可以灵活制备出具有薄壁、格栅、中空点阵等 结构复杂且成形难度较大的零件<sup>[6]</sup>。

由于铝合金对激光能量的吸收率较低,关于 SLM成形铝合金的研究仍处在优化成形工艺参数 阶段。通过不断优化 SLM成形工艺参数,可得到 致密度大于 99.0%、拉伸性能良好(抗拉强度大于 300 MPa,延伸率大于 10%)的铝合金试样<sup>[7-10]</sup>。 但实际成形过程中,除成形质量外,还需考虑成形 效率。市场上通常用成熟的 SLM 成形设备进行 铝合金成形,铺粉层厚为 20~50 μm<sup>[11-13]</sup>,铝合金 零件的成形效率和性能存在一定的局限性。增加 铺粉层厚可提高零件的成形效率,但 SLM 成形技 术的逐层叠加特点,使层厚不仅决定了激光功率 等参数的选取,还决定了单道熔池的尺寸、散热速 率等特性,进而决定了成形件的组织与性能。若 过度增大铺粉层厚,会导致成形件的表面质量严 重下降,同时会增加冶金缺陷,降低成形件的力学 性能<sup>[14]</sup>。

目前,关于不同层厚对 SLM 成形铝合金组织 性能及成形效率的影响研究较少。因此,本文用不 同层厚下的优化工艺参数研究了 AlSi10Mg 合金的 成形技术,并分析了铺粉层厚对试样致密度、组织性 能、缺陷以及成形效率的影响规律,为 SLM 成形 AlSi10Mg 合金在工程中的应用提供了参考。

收稿日期: 2020-07-28; 修回日期: 2020-09-10; 录用日期: 2020-10-27

<sup>\*</sup>E-mail: hwtkjcbq1984@163.com

#### 第48卷第10期/2021年5月/中国激光

#### 2 实验材料与方法

实验选用的原材料为气雾化法制备的 AlSi10Mg合金粉末,其化学元素的质量分数如表1 所示,粉末形貌和粒径分布如图1和图2所示。可 以发现,AlSi10Mg合金的粉末颗粒大部分近似呈 球形,表面质量良好,小部分颗粒呈不规则椭球形, 粉末平均粒径为 27.34  $\mu$ m。实验用 Concept Laser 公司的 X Line 1000R 型号 SLM 合金成形设备,最 大成形尺寸为 630 mm×400 mm×500 mm,配置 的高功率光纤激光器的功率为1 kW。成形前,将铝 合金基板预热至 150 ℃,并在成形舱内充满体积分 数不小于 99.99 %的氩气,以保证成形过程中氧的 体积分数小于 0.1%。

|               |         |         | 表   | 1 AlSi10                 | )Mg 合金     | 粉末中元   | 素的质量      | 量分数             |                   |       |   |         |
|---------------|---------|---------|---|--------------------------|------------|--|-----------|-----------------|-------------------|-------|---|---------|
|               |         | Ta      | ble 1 N   | lass fracti              | ion of ele | ement in A   | AlSi10Mg  | g alloy pe      | owder             |       |   | unit: ½ |
| Element       | Al      | Si      | Mg  | Ti                       | Ni         | Mn   | Cu        | Fe              | Zn                | Pb    | Sn  | 0       |
| Mass fraction | balance | 10.00   | 0.34  | <0.01                    | <0.01      | <0.01  | <0.01     | 0.034           | <0.01             | <0.01 | <0.01   | 0.070   |
|               |         |         | × 200 | 5.0kV sti 22<br>Si10Mg 合 | · 金粉末自     | ( <sup>1</sup> )<br>( <sup>1</sup> ) |           | x 500<br>;(b) × | 15.0KV SEL<br>500 |       | and of the second se |         |
|               |         | 100.0 - | torpholog   | gy of the                | AISHUM     | g alloy po   | owder. (a | a) × 200        | ; (b) ×           | 000   |   |         |
|               |         | 100.0   |   |                          |            |  |           |                 | 25.0              | J     |   |         |





SLM 成形 AlSi10Mg 合金的铺粉层厚通常为 20~50  $\mu$ m,该范围内的已有研究结果表明,当铺粉 层厚为 30  $\mu$ m 时,成形的 AlSi10Mg 合金性能最优。 为了提高成形效率,满足生产需求,还需研究更高层 厚下合金试样的成形效果,因此,实验选取 60  $\mu$ m 高层厚与 30  $\mu$ m 低层厚合金试样进行对比。考虑 到 60  $\mu$ m 高层厚粉末需要较高的功率进行熔透,固 定铺粉层厚之后,用直径为 0.2 mm 的光斑、功率为 890 W 的激光进行实验,其他成形工艺参数如表 2 所示。其中,扫描速度每次增加 100 mm/s。用表 2 中的成形工艺参数制备一系列尺寸为8 mm× 8 mm×5 mm的方形试样,尺寸为13 mm×13 mm× 73 mm的方形试棒(垂直成形方向,下文简称为 X/Y方向)及直径为13.5 mm,高为73 mm的圆柱 形试棒(平行成形方向,下文简称为Z方向),成形 试样如图3所示。取2块方形试样用于观察组织形 貌,各取3根方形试棒和圆柱形试棒用于拉伸性能 测试。成形结束后,将试样置于260℃的温度下进 行2h去应力退火处理。

#### 表 2 SLM 成形的工艺参数

Table 2 Process parameters of the SLM forming

| No. | Layer thickness $/\mu m$ | Spot diameter $/\rm mm$ | Laser power $/  W$ | Scanning speed /(mm $\cdot$ s <sup>-1</sup> ) | Hatch spacing $/mm$ |
|-----|--------------------------|-------------------------|--------------------|---|---------------------|
| 1   | 30                       | 0.1                     | 350                | 1400-1800                                     | 0.16                |
| 2   | 60                       | 0.2                     | 890                | 1600-2000                                     | 0.20                |



图 3 部分成形试样的图像 Fig. 3 Image of the partially formed sample

将方形试样进行超声清洗烘干后,先用阿基米 德排水法测量试样的致密度;然后对试样进行镶嵌、 打磨、抛光,并用 Keller 试剂腐蚀 30 s;最后用清水 冲洗试样,用 HNO。溶液清洗腐蚀产物,并再次用 清水冲洗吹干。用 Leica DM4000 型金相显微镜和 FEI Nano 450 型场发射扫描电子显微镜(FESEM) 观察试样的微观组织及内部孔洞,并用 Image-Pro Plus 图像软件统计试样缺陷的尺寸信息。成形的圆柱形和方形试棒按 GB/T 228.1-2010 加工成直径为 12 mm,高为 71 mm 的标准室温拉伸试样,用AG-IS250kN型万能材料试验机进行拉伸性能测试,并用 FESEM 观察拉伸断口的形貌。

#### 3 实验结果及分析

#### 3.1 不同层厚下试样的致密度与拉伸性能

试样的成形质量受激光功率、扫描速度、铺粉层 厚等工艺参数的综合影响,激光能量密度指单位体 积内粉末吸收的激光能量,可表示为<sup>[15-16]</sup>

$$E = \frac{P}{v \times h \times t},\tag{1}$$

弦密度;然后对试样进行镶嵌、 r 试剂腐蚀 30 s;最后用清水 F液清洗腐蚀产物,并再次用 ca DM4000 型金相显微镜和 材扫描电子显微镜(FESEM) 达内部孔洞,并用 Image-Pro 表3 30  $\mu$ m 层厚下 AlSi10Mg 合金试样的工艺参数,能量密度和致密度

Table 3 Process parameters, energy density and relative density of AlSi10Mg alloy sample under 30 µm layer thickness

| Layer thickness / | Spot diameter / | Laser power /<br>W | Hatch spacing / | Scanning speed / $(mm \cdot s^{-1})$ | Energy density / $(1 \cdot mm^{-3})$ | Relative density / |
|-------------------|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|
| µm                | 11111           |                    | 111111          | (11111 • 5 )                         | ()•                                  | 20                 |
|                   |                 |                    |                 | 1400                                 | 52.08                                | 98.88              |
|                   |                 |                    |                 | 1500                                 | 48.61                                | 98.88              |
| 30                | 0.1             | 350                | 0.16            | 1600                                 | 45.57                                | 99.25              |
|                   |                 |                    |                 | 1700                                 | 42.89                                | 99.25              |
|                   |                 |                    |                 | 1800                                 | 40.51                                | 98.88              |







示。可以发现,该参数范围内成形的 AlSi10Mg 合 金试样致密度均大于等于 98.88%,且组织均匀,孔 洞缺陷较少,可观察到相互垂直的熔池编织形貌和 激光束的扫描轨迹。当扫描速度为 1600 mm/s 和 1700 mm/s,即激光能量密度为 45.57 J/mm<sup>3</sup> 和 42.89 J/mm<sup>3</sup> 时,合金试样的致密度最高,可达到 99.25%。

用表 2 中第 2 组工艺参数进行 60 μm 高层厚 AlSi10Mg 合金试样的成形实验,测量并计算对应 的激光能量密度和致密度,结果如表 4 和图 5 所示。 可以发现,60 μm 高层厚与 30 μm 低层厚成形的 AlSi10Mg 合金试样致密度处于同一水平,均大于 等于98.88%,且具有均匀致密的微观组织。当扫

Table 4

100

| 表 4                 | 60 µm 层厚下 AlSi10 Mg 台金试件的工艺参数、能重密度和致密度  |                   |
|---------------------|---|-------------------|
| Process parameters, | , energy density and relative density of AlSi10Mg alloy sample under 60 $\mu$ m | n layer thickness |

| Layer thickness / | Spot diameter / | Laser power / | Hatch spacing / | Scanning speed /    | Energy density /    | Relative density |
|-------------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------------|---------------------|------------------|
| $\mu \mathrm{m}$  | mm              | W             | mm              | $(mm \cdot s^{-1})$ | $(J \cdot mm^{-3})$ | %                |

| $\mu$ m | mm  | W   | mm   | $(mm \cdot s^{-1})$ | $(J \cdot mm^{-3})$ | %     |  |
|---------|-----|-----|------|---------------------|---------------------|-------|--|
|         |     |     |      | 1600                | 46.35               | 98.88 |  |
|         |     |     |      | 1700                | 43.63               | 99.25 |  |
| 60      | 0.2 | 890 | 0.20 | 1800                | 41.20               | 99.25 |  |
|         |     |     |      | 1900                | 39.04               | 99.25 |  |
|         |     |     |      | 2000                | 37.08               | 98.88 |  |
|         |     |     |      |                     |                     |       |  |

60

energy density



- relative density

**\_\_**\_\_\_.

图 5 60 μm 层厚下 AlSi10Mg 合金试样的致密度及对应 能量密度

Fig. 5 Relative density and corresponding energy density of AlSi10Mg alloy sample under 60  $\mu m$  layer thickness

40025tensile strength (a) 30 µm 60 µm yield strength elongation 20**Fensile strength /MPa** 289.9300 283.7276.8273.8 269.1 15 10 Elongation /% 3.84|4.5214.36 200 13.78 1005 0 0 1600 1700 1700 1800 1900 Scanning speed /(mm·s<sup>-1</sup>)

描速度为 1700~1900 mm/s时,激光能量密度从

43.63 J/mm<sup>3</sup>下降到 39.04 J/mm<sup>3</sup>,试样致密度可 达到 99.25%。

在提升试样致密度的基础上,优化试样的力学 性能也是 SLM 成形 AlSi10Mg 合金的必要条件。 从表 3、表 4 中选出 5 组致密度高于 99.00%的 AlSi10Mg 合金试样,测试其室温拉伸性能,结果如 图 6 所示。可以发现,5 组试样均具有较好的拉伸性 能(X/Y 方向的抗拉强度大于等于 269.1 MPa,延伸 率大于等于 13.78%; Z 方向的抗拉强度大于等于 278.2 MPa,延伸率大于等于 8.16%)。但 30 μm 低 层厚成形的 AlSi10Mg 合金试样抗拉强度和屈服强度 均略高于 60 μm 高层厚; 30 μm 低层厚和 60 μm 高层 厚成形的合金试样延伸率基本相当,但在 Z 方向 30 μm 低层厚成形的合金试样延伸率略高。





#### 3.2 不同层厚下合金的微观组织

AlSi10Mg 合金试样的力学性能与其致密度、 微观组织形貌息息相关,为了分析不同层厚成形的 AlSi10Mg 合金试样致密度及拉伸性能差异的原 因,选择1组30 μm 低层厚和1组60 μm 高层厚下 致密度高、强度与塑性匹配较好的成形试样进行分 析,试样对应的成形参数、致密度及拉伸性能如表5 所示。 用表 5 中的参数成形的 AlSi10Mg 合金试样金 相组织如图 7 所示,通过高亮的熔池边界可以分辨 出激光扫描路径及层与层之间的堆叠现象。在 X/ Y 方向,扫描路径沿相互垂直的 2 个方向排布,但 60 μm 高层厚下的扫描路径明显宽于 30 μm 低层 厚,且相邻平行熔池间的重叠比例更大,如图 7(a)、 图 7(c)所示;在 Z 方向可观察到圆弧状熔池沿成形 方向逐层堆叠的鱼鳞状形貌,但 60 μm高层厚下的

|                      | Table 5 Parameters of AlSi10Mg alloy samples under different layer thicknesses |     |                     |  |                     |                          |       |                |       |       |  |
|----------------------|--|-----|---------------------|--|---------------------|--------------------------|-------|----------------|-------|-------|--|
| Layer<br>thickness / | Spot Laser Hatch Scanning<br>/ diameter / power / spacing / speed /            |     | Energy<br>density / | Energy Relative<br>density / density / |                     | Tensile<br>strength /MPa |       | Elongation / % |       |       |  |
| $\mu \mathrm{m}$     | mm   | W   | mm                  | $(mm \cdot s^{-1})$                    | $(J \cdot mm^{-3})$ | 0/0                      | X/Y   | Ζ              | X/Y   | Ζ     |  |
| 30                   | 0.1  | 350 | 0.16                | 1600                                   | 45.57               | 99.25                    | 283.7 | 292.3          | 13.84 | 13.07 |  |
| 60                   | 0.2  | 890 | 0.20                | 1700                                   | 43.63               | 99.25                    | 276.8 | 285.1          | 14.36 | 9.97  |  |



| Table 5 | Parameters of  | AlSi10Mg | allov | samples | under | different | laver    | thicknesses    |
|---------|----------------|----------|-------|---------|-------|-----------|----------|----------------|
| rubic o | i arametero or | THOITONE | uno y | oumpico | under | uniterent | ILL Y CI | ciffenii cooco |



图 7 不同层厚下试样的金相图。(a) 30 µm 层厚, X/Y 方向; (b) 30 µm 层厚, Z 方向; (c) 60 µm 层厚, X/Y 方向; (d) 60 µm 层厚, Z 方向

Fig. 7 Metallographic diagrams of samples with different layer thicknesses. (a) Layer thickness is  $30 \ \mu m$ , X/Y direction; (b) layer thickness is 30  $\mu$ m, Z direction; (c) layer thickness is 60  $\mu$ m, X/Y direction; (d) layer thickness is 60  $\mu$ m, Z direction

熔池深度与宽度明显大于 30 μm 低层厚, 如 图 7(b)、图 7(d)所示。原因是 60 μm 高层厚下,为 保证粉末完全熔化,增加了光斑直径及激光功率。 由表 5 中的室温拉伸结果可知,60 μm 高层厚与 30 µm 低层厚成形的合金试样在 Z 方向的延伸率 差别较大,该现象可能与拉伸断裂过程中裂纹扩展 的难易程度有关,即熔池边界组织比熔池内部组织 更粗大,易成为裂纹扩展的薄弱界面,裂纹的扩展路 径如图 7(b)、图 7(d)中的虚线所示。可以发现, 30 µm 低层厚下熔池尺寸较小,组织排布密集,裂纹 扩展路径更曲折,扩展难度更大;而 60 µm 高层厚 下熔池尺寸较大,裂纹扩展路径更平滑,扩展难度相 对较低。

表 6 为不同层厚下 AlSi10Mg 合金试样的孔洞 缺陷尺寸,可以发现,SLM 成形的 AlSi10Mg 合金 中的缺陷分布具有一定规律:30 µm 低层厚下缺陷 多分布在熔池边界,平均尺寸为 6.2 μm; 而 60 μm 高层厚下缺陷多分布在熔池内部,平均尺寸为 8.1 μm。这表明铺粉层厚较大时,容易形成尺寸较 大的孔洞。原因是 30 µm低层厚下光斑直径D为

表 6 不同层厚下 AlSi10Mg 合金试样的孔洞尺寸 Table 6 Hole sizes of AlSi10Mg alloy samples under different layer thicknesses

| Lover         |     | Holes | ze /um | -   |                     |
|---------------|-----|-------|--------|-----|---------------------|
| thickness /µm | 1   | 2     | 3      | 4   | — Average value /μm |
| 30            | 5.6 | 6.1   | 6.1    | 7.4 | 6.2                 |
| 60            | 7.0 | 7.7   | 8.8    | 8.9 | 8.1                 |

#### 第48卷第10期/2021年5月/中国激光

0.1 mm,扫描间距 h 为 0.16 mm; 而 60 μm 高层 厚下光斑 直径 D 为 0.2 mm,扫描间距 h 为 0.20 mm。30 μm 低层厚和 60 μm 高层厚下的熔 池重叠示意图如图 8 所示,可以发现,30 μm 低层 厚下相邻熔池间的重叠区域较小,导致相邻熔池 之间可能出现空隙,凝固过程中在熔池边界区域 生成孔洞缺陷; 而 60 μm 高层厚下熔池之间的重 叠区域较大,有利于填补熔池之间的空隙,熔池边 界处的孔洞缺陷较少。但 60 μm 高层厚下的激光 功率较大,部分粉末完全熔化后会以液滴的形式 飞溅出来,从而在当前铺粉层表面凝固形成金属 球(球化现象)。进行下一层铺粉时,粉末无法填 充金属球之间的空隙,从而在该区域产生尺寸较 大的缺陷。





用 FESEM 对不同层厚的 AlSi10Mg 合金试样 熔池边界与熔池内部组织进行观察分析,结果如 图 9 所示。可以发现,SLM 成形的 AlSi10Mg 合金 微观组织由深色基体与基体上分布的白色网状组织 组成。结合文献[17-19]可知,深色基体为 Al 基体, 白色网状组织为析出的共晶 Si。30  $\mu$ m 低层厚和 60  $\mu$ m 高层厚成形试样组织中,网状共晶 Si 的整体 分布无显著差异,但共晶 Si 的尺寸存在差异。其 中,D1~D7 为实测共晶 Si 的尺寸。根据组织中网 状共晶 Si 的尺寸和分布情况,将熔池分为熔池内部 和熔池边界<sup>[19]</sup>,可以发现,30  $\mu$ m 低层厚下,熔池内 部共晶 Si 的尺寸约为 0.09~0.10  $\mu$ m,熔池边界共 晶 Si 的尺寸约为 0.20  $\mu$ m;60  $\mu$ m 高层厚下,熔池 内部共晶 Si 的尺寸约为 0.12~0.15  $\mu$ m,熔池边界 共晶 Si 的尺寸约为 0.32  $\mu$ m。

熔池内部的网状共晶 Si 尺寸小于熔池边界的 网状共晶 Si 尺寸,原因是熔池边界为相邻熔池的重 叠部分,两次加热减缓了熔池边界的冷却速率,共晶 Si 颗粒有更充分的时间析出长大。对比不同层厚 下 AlSi10Mg 合金试样的微观组织形貌发现,60 μm 高层厚下的合金试样组织中,网状共晶 Si 的尺寸在 熔池内部和熔池边界上均大于 30 μm 低层厚下合 金试样对应区域的组织,这种差异也与冷却速率有 关。Hofmeister 等<sup>[20]</sup>和 Ma 等<sup>[21]</sup>描述了 SLM 过 程中熔池的冷却速度,可表示为



- 图 9 不同层厚 AlSi10Mg 合金试样的 FESEM 图像 (X/Y 方向)。(a) 30 μm 层厚,熔池内部;
   (b) 30 μm 层厚,熔池边界;(c) 60 μm 层厚,熔池 内部;(d) 60 μm 层厚,熔池边界
- Fig. 9 FESEM images of AlSi10Mg alloy samples with different layer thicknesses (X/Y direction).
  (a) Layer thickness is 30 μm, inside the molten pool; (b) layer thickness is 30 μm, boundary the molten pool; (c) layer thickness is 60 μm, inside the molten pool; (d) layer thickness is 60 μm, boundary the molten pool

$$\Delta v_{\mathrm{T}} = C \cdot E \cdot v^{1/2} \cdot d^{-(3/2)}, \qquad (2)$$

#### 第 48 卷 第 10 期/2021 年 5 月/中国激光

式中, $\Delta v_{T}$  为熔池冷却速度,C 为与粉末材料有关的 常数,d 为层厚。由表 5 可知,30  $\mu$ m 低层厚和 60  $\mu$ m 高层厚选用的成形参数中,激光能量密度 E和激光扫描速度 v 相差不大,因此层厚 d 对熔池冷 却速度  $\Delta v_{T}$  的影响最大。在 30  $\mu$ m 低层厚下的冷 却速度较高,整个熔池内共晶 Si 的尺寸更精细;而 60  $\mu$ m 高层厚下熔池冷却速度较低,熔池内共晶 Si 的尺寸更粗大。根据细晶强化理论<sup>[22]</sup>可知,晶粒的 尺寸越小,金属的强度越高,因此 30  $\mu$ m 低层厚下 成形的 AlSi10Mg 合金抗拉强度略高于 60  $\mu$ m 高层 厚下成形的 AlSi10Mg 合金。

#### 3.3 不同层厚下的拉伸断口

图 10 为用表 5 中工艺参数成形的 AlSi10Mg 合金试样的宏观拉伸断口形貌。可以发现,30 μm 低层厚和 60 μm 高层厚下的 Z 方向断口相对平整, 存在相互垂直的熔道排布,孔洞较少;而 X/Y 方向 断口表面起伏较大,可观察到较多的孔洞。原因是 拉伸过程中裂纹会沿组织薄弱的界面进行扩展,在 Z 方向试样拉伸过程中,熔池边界的共晶 Si 尺寸相 更粗大,该区域抵抗裂纹扩展的能力也较弱,容易成 为裂纹扩展的薄弱区域,因此,裂纹会沿熔池边界扩



- 图 10 不同层厚下 AlSi10Mg 合金试样的宏观拉伸断口 形貌。(a) 30 μm 层厚,X/Y 方向;(b) 30 μm 层 厚,Z 方向;(c) 60 μm 层厚,X/Y 方向;(d) 60 μm 层厚,Z 方向
- Fig. 10 Macroscopic tensile fracture morphology of AlSi10Mg alloy samples with different layer thicknesses. (a) Layer thickness is 30  $\mu$ m, X/ Y direction; (b) layer thickness is 30  $\mu$ m, Z direction; (c) layer thickness is 60  $\mu$ m, X/Y direction; (d) layer thickness is 60  $\mu$ m, Z direction

展直至断裂,如图 10(b)、图 10(d)所示。而在 X/Y 方向试样中,熔池之间相互垂直排布,导致裂纹沿熔 池边界持续扩展的难度较大,裂纹容易沿孔洞、裂纹 等缺陷和组织薄弱区的界面进行扩展,因此,组织中 的孔洞等缺陷更容易暴露于该方向试样的断口 表面。

图 11 为不同层厚下成形试样拉伸断口的微观 形貌,可以发现,在 30  $\mu$ m 低层厚下,X/Y 方向和 Z 方向拉伸断口表面的韧窝具有相似的形貌特征,整 体分布均匀,尺寸约为 0.5  $\mu$ m;而 60  $\mu$ m 高层厚下, X/Y 方向和 Z 方向拉伸断口表面韧窝形貌差别较 大,X/Y 方向断口的韧窝分布不均匀,尺寸约为 1~ 2  $\mu$ m,深度较深; Z 方向断口的韧窝尺寸约为 0.5  $\mu$ m,且深度较浅。此外,60  $\mu$ m 高层厚试样断 口的 韧窝周围分布着孔洞缺陷,如图 10 (c)、 图 10(d)所示,这些孔洞会破坏铝基体的连续性,导 致裂纹快速扩展和组织失效。



- 图 11 不同层厚下 AlSi10Mg 合金试样的微观拉伸断口 形貌。(a) 30 μm 层厚,X/Y 方向;(b) 30 μm 层
   厚,Z 方向;(c) 60 μm 层厚,X/Y 方向;(d) 60 μm
   层厚,Z 方向
- Fig. 11 Microscopic tensile fracture morphology of AlSi10Mg alloy samples with different layer thicknesses. (a) Layer thickness is 30  $\mu$ m, X/ Y direction; (b) layer thickness is 30  $\mu$ m, Z direction; (c) layer thickness is 60  $\mu$ m, X/Y direction; (d) layer thickness is 60  $\mu$ m, Z direction

#### 3.4 不同层厚下的成形效率

SLM成形工艺的生产效率一般用成形速率(V<sub>b</sub>)表示<sup>[23]</sup>,即

#### 第48卷第10期/2021年5月/中国激光

 $V_b = t \times h \times v$ 。 (3) 可以发现,要想提高成形速率,则需在高铺粉层 厚下尽量提升扫描速度和加宽扫描间距。实验在铺 粉层厚分别为 30  $\mu$ m 和 60  $\mu$ m 时,合理设置扫描速 度和扫描间距,使粉末吸收的激光能量密度近似,从 而保证 AlSi10Mg 合金的成形质量。在保证成形质 量的前提下,通过(3)式计算出不同层厚下 AlSi10Mg合金的SLM成形速率,结果如表7所 示。可以发现,在实验选择的工艺参数窗口内,将铺 粉层厚从30μm增加至60μm,可在不明显降低成 形质量的情况下,使成形效率提高2.7倍。

表 7 不同铺粉层厚优化工艺参数下 AlSi10Mg 合金试样的成形速率

| Table 7 | Forming rates of | t AlSi10Mg alloy | samples w | vith optimized | process | parameters | under | different | thicknesses |
|---------|------------------|------------------|-----------|----------------|---------|------------|-------|-----------|-------------|
|---------|------------------|------------------|-----------|----------------|---------|------------|-------|-----------|-------------|

| Layer<br>thickness /µm | Spot<br>diameter /mm | Laser<br>power /W | Scanning speed /<br>(mm • s <sup>-1</sup> ) | Hatch spacing / mm | Energy density /<br>(J • mm <sup>-3</sup> ) | Forming rate / $(mm^3 \cdot s^{-1})$ |
|------------------------|----------------------|-------------------|---|--------------------|---|--------------------------------------|
| 30                     | 0.1                  | 350               | 1600  | 0.16               | 45.57                                       | 7.68                                 |
| 60                     | 0.2                  | 890               | 1700  | 0.20               | 43.63                                       | 20.40                                |

#### 4 结 论

1) 在实验采用的成形参数范围内,30 μm 低层
 厚和 60 μm 高层 厚均可得到致密度不小于
 99.00%、拉伸性能良好的 AlSi10Mg 合金。

2) 30 μm 低层厚成形的 AlSi10Mg 合金试样强 度略高于 60 μm 高层厚,原因是 30 μm 低层厚试样 组织中的共晶 Si 尺寸较小;30 μm 低层厚下试样的 纵向延伸率明显高于 60 μm 高层厚,原因是 30 μm 低层厚下的熔池尺寸更小且组织排布密集。研究结 果还表明,30 μm 低层厚下的缺陷多分布在熔池边 界,而 60 μm 高层厚下缺陷多分布在熔池内部。

3) 不同层厚下 AlSi10Mg 合金试样的 Z 方向 断口均可观察到相互垂直的熔道,原因是熔池边界 的共晶 Si 尺寸相对粗大,易成为裂纹扩展的薄弱区 域。30 μm 低层厚下断口韧窝分布均匀,尺寸约为 0.5 μm。但 60 μm 高层厚下的微观断口中,X/Y 方向的韧窝尺寸约为 1~2 μm,深度较深, m Z 方 向韧窝尺寸约为 0.5 μm。

 4) 在致密度均大于 99.00%且拉伸性能相近的 情况下,60 μm 高层厚 AlSi10Mg 合金的成形效率 约为 30 μm 低层厚的 2.7 倍。

#### 参考文献

- [1] Ke Y, Ma P, Ma Y C, et al. Microstructure and mechanical properties of AlSi10Mg alloy fabricated by selective laser melting [J]. Applied Laser, 2019, 39 (2): 198-203.
  柯宇,马盼,马永超,等.激光选区熔化 AlSi10Mg 合金微观组织及力学性能研究 [J].应用激光, 2019, 39(2): 198-203.
- [2] Gu D D, Zhang H M, Chen H Y, et al. Laser additive manufacturing of high-performance metallic

aerospace components[J]. Chinese Journal of Lasers, 2020, 47(5): 0500002.

顾冬冬,张红梅,陈洪宇,等.航空航天高性能金属 材料构件激光增材制造[J].中国激光,2020,47 (5):0500002.

- Li N, Huang S, Zhang G D, et al. Progress in additive manufacturing on new materials: a review
   [J]. Journal of Materials Science & Technology, 2019, 35(2): 242-269.
- [4] Liu W, Li N, Zhou B, et al. Progress in additive manufacturing on complex structures and high-performance materials [J]. Journal of Mechanical Engineering, 2019, 55(20): 128-151, 159.
  刘伟,李能,周标,等.复杂结构与高性能材料增材 制造技术进展[J]. 机械工程学报, 2019, 55(20): 128-151, 159.
- [5] DebRoy T, Wei H L, Zuback J S, et al. Additive manufacturing of metallic components: process, structure and properties [J]. Progress in Materials Science, 2018, 92: 112-224.
- [6] Yang Y Q, Wu S B, Zhang Y, et al. Application progress and prospect of fiber laser in metal additive manufacturing[J]. Chinese Journal of Lasers, 2020, 47(5): 0500012.
  杨永强,吴世彪,张越,等.光纤激光器在金属增材 制造中的应用进展及展望[J].中国激光, 2020, 47(5): 0500012.
- [7] Li X P, Wang X J, Saunders M, et al. A selective laser melting and solution heat treatment refined Al-12Si alloy with a controllable ultrafine eutectic microstructure and 25% tensile ductility [J]. Acta Materialia, 2015, 95: 74-82.
- [8] Zou Y T, Wei Z Y, Du J, et al. Effect and optimization of processing parameters on relative density of AlSi10Mg alloy parts by selective laser melting[J]. Applied Laser, 2016, 36(6): 656-662. 邹亚桐,魏正英,杜军,等. AlSi10Mg激光选区熔化

#### 第48卷第10期/2021年5月/中国激光

#### 研究论文

成形工艺参数对致密度的影响与优化[J].应用激 光,2016,36(6):656-662.

- [9] Zhang W Q, Zhu H H, Hu Z H, et al. Study on the selective laser melting of AlSi10Mg[J]. Acta Metallurgica Sinica, 2017, 53(8): 918-926.
  张文奇,朱海红,胡志恒,等. AlSi10Mg 的激光选区 熔化成形研究[J]. 金属学报, 2017, 53(8): 918-926.
- [10] Hou W, Chen J, Chu S L, et al. Anisotropy of microstructure and tensile properties of AlSi10Mg formed by selective laser melting[J]. Chinese Journal of Lasers, 2018, 45(7): 0702003.
  侯伟,陈静,储松林,等.选区激光熔化成形 AlSi10Mg 组织与拉伸性能的各向异性研究[J].中国激光, 2018, 45(7): 0702003.
- [11] Rosenthal I, Stern A, Frage N, et al. Strain rate sensitivity and fracture mechanism of AlSi10Mg parts produced by selective laser melting [J]. Materials Science and Engineering: A, 2017, 682: 509-517.
- [12] Deng Z J, Cheng Q L, Ke L D, et al. Study on density and mechanical properties of AlSi10Mg alloy prepared by selection laser melting forming [J]. Foundry Technology, 2018, 39 (9): 1904-1906, 1915.
  邓竹君,成群林,柯林达,等.激光选区熔化成形

AlSi10Mg 合金构件致密度和力学性能研究[J]. 铸造技术, 2018, 39(9): 1904-1906, 1915.

- [13] Wang X J. Process parameters and properties of selective laser melting Al-Si alloys [D]. Beijing: China University of Geosciences, 2014: 52-68.
  王小军. Al-Si 合金的选择性激光熔化工艺参数与性能研究[D].北京:中国地质大学(北京), 2014: 52-68.
- [14] Aboulkhair N T, Maskery I, Tuck C, et al. On the formation of AlSi10Mg single tracks and layers in selective laser melting: microstructure and nanomechanical properties [J]. Journal of Materials Processing Technology, 2016, 230: 88-98.
- [15] Herzog D, Seyda V, Wycisk E, et al. Additive

manufacturing of metals [J]. Acta Materialia, 2016, 117: 371-392.

- [16] Zong X W, Gao Q, Zhou H Z, et al. Effects of bulk laser energy density on anisotropy of selective laser sintered 316L stainless steel [J]. Chinese Journal of Lasers, 2019, 46(5): 0502003.
  宗学文,高倩,周宏志,等.体激光能量密度对选区 激光熔化 316L 不锈钢各向异性的影响 [J].中国激 光, 2019, 46(5): 0502003.
  - Trevisan F, Calignano F, Lorusso M, et al. On the selective laser melting (SLM) of the AlSi10Mg alloy: process, microstructure, and mechanical properties
     [J]. Materials, 2017, 10(1): 76.
  - [18] Wu J, Wang X Q, Wang W, et al. Microstructure and strength of selectively laser melted AlSi10Mg [J]. Acta Materialia, 2016, 117: 311-320.
  - [19] Yan T Q, Tang P J, Chen B Q, et al. Effect of annealing temperature on microstructure and tensile properties of AlSi10Mg alloy fabricated by selective laser melting[J]. Journal of Mechanical Engineering, 2020, 56(8): 37-45.
    []泰起,唐鹏钧,陈冰清,等.退火温度对激光选区 熔化 AlSi10Mg 合金微观组织及拉伸性能的影响[J]. 机械工程学报, 2020, 56(8): 37-45.
  - [20] Hofmeister W, Griffith M. Solidification in direct metal deposition by LENS processing [J]. JOM, 2001, 53(9): 30-34.
  - [21] Ma M M, Wang Z M, Gao M, et al. Layer thickness dependence of performance in high-power selective laser melting of 1Cr<sub>18</sub> Ni<sub>9</sub> Ti stainless steel [J]. Journal of Materials Processing Technology, 2015, 215: 142-150.
  - [22] Liu Y D, Liu S Z, Song H D, et al. Fine-grain strengthening mechanism of low carbon martensite steel and its mechanical properties [J]. Journal of Northeastern University, 2014, 35(4): 499-503.
  - [23] Shi X Z, Ma S Y, Liu C M, et al. Performance of high layer thickness in selective laser melting of Ti<sub>6</sub> Al<sub>4</sub> V[J]. Materials, 2016, 9(12): 975.

### Effect of Layer Thickness on Forming Quality and Efficiency of AlSi10Mg Alloy Fabricated by Selective Laser Melting

Yan Taiqi<sup>1</sup>, Chen Bingqing<sup>1\*</sup>, Tang Pengjun<sup>1</sup>, Chu Ruikun<sup>2</sup>, Guo Shaoqing<sup>1</sup>

 $^{1}$  3D Printing Research and Engineering Technology Center, AECC Beijing Institute of Aeronautical Materials,

Beijing 100095, China;

<sup>2</sup> Falcon Fast Manufacturing Technology Co., Ltd., Wuxi, Jiangsu 214145, China

#### Abstract

**Objective** The rapid development of selective laser melting (SLM) technology provides an excellent solution for the rapid manufacturing of new complex aluminum alloy parts. Most studies on SLM of aluminum alloy remain in the stage of optimizing the processing parameters. Through continuous optimization of processing parameters, aluminum alloy samples with a density of over 99.00% and good tensile properties can be obtained. However, forming efficiency should also be considered in the actual forming process. To improve the forming efficiency, the most direct solution is to increase the layer thickness. The layer thickness determines the selection of other parameters, such as laser power, and the size of a single molten track and heat dissipation rate, which further determines the microstructure and properties of forming parts. Although properly increasing layer thickness is essential to improve the forming efficiency, if the layer thickness is excessively increased, decreasing the mechanical properties. There are few reports on the effect of different layer thickness on microstructure, properties, and forming efficiency of SLM of aluminum alloy. In this study, the forming technology of AlSi10Mg alloy is investigated using optimized process parameters under different layer thickness. Besides, the influence of layer thickness on density, microstructure and properties, defects, and forming efficiency is analyzed, which provided a reference for further application of laser selective melted AlSi10Mg alloy in engineering.

**Methods** AlSi10Mg powder with good appearance quality is selected. First, the aluminum alloy substrate is preheated to 150  $^{\circ}$ C, and the oxygen content in the forming chamber is kept below 0.1%. Concept laser X Line 1000R is selected as a SLM equipment. The high layer thickness of 60  $\mu$ m is compared with the low layer thickness of 30  $\mu$ m. Other processing parameters are designed based on the layer thickness, and a series of square blocks and bars are formed. After forming, the samples are annealed at 260  $^{\circ}$ C for 2 h. The densities of the samples are observed through the metallographic microscope and scanning electron microscope. The size of the samples' defects is counted using Image-Pro Plus. The formed bars are used to test the room-temperature tensile properties. Finally, the fracture morphology is observed and analyzed using a scanning electron microscope.

**Results and Discussions** The AlSi10Mg alloy with high density (Fig. 4 and Fig. 5) and good tensile properties (Fig. 6) can be formed under 30  $\mu$ m lower layer thickness and 60  $\mu$ m higher layer thickness. There are still differences as follows: the strength of AlSi10Mg alloy formed at 30  $\mu$ m layer thickness is slightly higher than that of 60  $\mu$ m layer thickness. This is attributed to the fine grain strengthening effect caused by smaller eutectic Si size in the 30  $\mu$ m lower layer thickness is significantly higher than that at 60  $\mu$ m higher layer thickness. This is because the molten pool at 30  $\mu$ m lower layer thickness is significantly higher than that at 60  $\mu$ m higher layer thickness. This is because the molten pool at 30  $\mu$ m lower layer thickness is smaller and densely arranged, leading to more zigzag crack propagation path and increased the difficulty of crack propagation; thus, resulting in a higher elongation (Fig. 7). The results showed that the defects with 30  $\mu$ m lower layer thickness are more distributed in the molten pool boundary, while the defects with 60  $\mu$ m higher layer thickness is perpendicular to each other (Fig. 10) since the eutectic Si in the boundary is relatively coarse, which becomes the weak area of crack propagation. When the AlSi10Mg alloy samples are with a density of over 99.00% and similar tensile properties, the forming efficiency with 60  $\mu$ m higher layer thickness is about 2.7 times higher than that of 30  $\mu$ m lower layer thickness.

Conclusions The layer thickness effect on relative density, microstructure, tensile properties, and forming

efficiency of AlSi10Mg alloy fabricated by SLM investigated. The results showed that within the optimized laser energy density range, the relative density of the samples fabricated at 30  $\mu$ m lower layer thickness and 60  $\mu$ m higher layer thickness reached over 99.00% and possessed good tensile properties. The tensile strength of the 30  $\mu$ m lower layer thickness sample is slightly higher than that of the 60  $\mu$ m higher layer thickness sample, which is attributed to the fine grain strengthening effect caused by the finer eutectic Si in the 30  $\mu$ m lower layer thickness sample. The Z-direction elongation of the 30  $\mu$ m lower layer thickness sample is significantly larger than that of the 60  $\mu$ m higher layer thickness sample since it is not easy for cracks to propagate along the smaller and more densely arranged molten pool boundaries in the 30  $\mu$ m lower layer thickness samples. The defects in the 30  $\mu$ m lower layer thickness sample are distributed along the molten pool boundaries, while the defects in the 60  $\mu$ m higher layer thickness is about 2.7 times higher than that of 30  $\mu$ m lower layer thickness with similar forming quality.

**Key words** laser technique; selective laser melting; powder layer thickness; relative density; tensile properties; forming efficiency

OCIS codes 140.3390; 160.3900; 350.3850